

「2020年までの電子部品技術ロードマップ」報告会

- 主催：部品技術ロードマップ専門委員会
- 担当部署：電子部品部
- 参加者数：約85名

概要

当協会の部品技術ロードマップ専門委員会（石井浩一 主査／TDK-EPC(株)）では、委員会活動の一環として、2年に1回「電子部品技術ロードマップ」を取りまとめ発行しております。この度、(財)大阪国際交流センターにおいて、標記報告会を開催いたしました。

本ロードマップでは、電子部品を扱う技術者あるいは関係者を対象に、電子部品を取り巻く環境、電子部品の現状、10年後までの今後の動向、および将来への夢

などを提示しております。最初に注目した機器市場の10年後の動向について委員会内で研究した結果を解説し、そこから導かれる電子部品への要求案件を切り口の一つとして電子部品の技術動向に反映しております。

報告会は、技術委員会幹事長を務める永松昇二氏（パナソニックエレクトロニクスデバイス(株)）による開会挨拶の後、以下プログラムで進められました。

プログラム

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ○開会挨拶 | 永松昇二氏（パナソニック エレクトロニクスデバイス(株)） |
| ○「全体概略説明」 | 石井浩一氏（TDK-EPC(株)） |
| ○「ホームデジタルAV機器」 | 渡部秀一氏（スミダ電機(株)） |
| ○「携帯通信機器／携帯情報機器」 | 鈴木幸春氏（(株)タムラ製作所） |
| ○「カーエレクトロニクス」 | 豊田 進氏（KOA(株)） |
| ○「インダクタ」 | 小林和義氏（太陽誘電(株)） |
| ○「抵抗器」 | 豊田 進氏（KOA(株)） |
| ○「コンデンサ」 | 棟方正一氏（NECトーキン(株)） |
| ○「LCR部品共通課題」 | 花輪 威氏（双信電機(株)） |
| ○「半導体セラミックス」 | 石井浩一氏（TDK-EPC(株)） |
| ○「EMC部品」 | 鈴木幸春氏（(株)タムラ製作所） |
| ○「コネクタ」 | 田嶋晋二氏（SMK(株)） |
| ○「高周波モジュール」 | 梶田 栄氏（(株)村田製作所） |
| ○「入出力デバイス」 | 田嶋晋二氏（SMK(株)） |
| ○「センサ・アクチュエータ」 | 石井浩一氏（TDK-EPC(株)） |
| ○「スマートコミュニティ」 | 梶田 栄氏（(株)村田製作所） |
| ○「部品材料」 | 野澤康人氏（日立金属(株)） |

